

Mechatronische Produkte

Neue FOUP Loadport-Modelle vorgestellt

- TDK hat ein Hochleistungs-FOUP-Modell entwickelt und vorgestellt, das mit der nächsten Generation der 450 mm Wafers kompatibel ist; sowie ein neues Modell für 300 mm Wafers, das die Kosten senkt und so die Wettbewerbsfähigkeit verbessert.

03. Juli 2012

Die TDK Corporation Die TDK Corporation hat zwei neue FOUP* Loadport-Modelle (TAS450 Typ A2 und TAS300 Typ J1) für eine Halbleiterproduktionsanlage entwickelt. Beide Modelle werden ab Juli 2012 erhältlich sein.

Für eine moderne Halbleiterfertigung ist eine besonders reine Umgebung erforderlich, die jedoch erhebliche Investitionen in große Luftreinigungsanlagen und weitere Einrichtungen verlangt. Um die Investitionen im Rahmen zu halten, haben sich in den letzten Jahren automatisierte Transportsysteme durchgesetzt, die die Halbleitersubstrate (Wafers) in vollständig gekapselte Transportbehälter (FOUP) einlegen und so zu den einzelnen Produktionseinrichtungen bringen.

Nachstehend finden Sie eine Zusammenfassung zu den beiden neuen von TDK entwickelten und vorgestellten FOUP Loadport-Modellen

TAS450 Typ A2: Haupteigenschaften und -vorteile

Neues Modell mit niedrigerem Gewicht für höhere Geschwindigkeiten auf höchstem Niveau, um die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.

Dieses Produkt ist das erste moderne Transportsystem für die Halbleiterproduktion, das die großen 450 mm Siliziumwafers aufnimmt, die als Technologie der nächsten Generation in der Halbleiterindustrie erwartet werden.

Wichtigste Merkmale dieses Produkts sind Innovationen bei der Klappe, die sowohl verhindern, dass Partikel von außen während des Einlegens und der Entnahme der Wafers in die Halbleiterproduktion gelangen, als auch, dass durch den Loadport selbst Partikel entstehen.

TAS300 Typ J1: Haupteigenschaften und -vorteile

Neues Modell mit niedrigerem Gewicht für höhere Geschwindigkeiten in der höchsten Klasse, um die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.

Dieses Produkt ist ein Transportsystem für Wafers mit einem Durchmesser von 300 mm, die in der Halbleiterproduktion aktuell eingesetzt werden. Es wurde entwickelt, um durch eine Senkung der Kosten die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Das Modell TAS300 Typ J1 ist der Nachfolger des 2009 vorgestellten Typs H1. Das Gesamtgewicht des Loadports ist um die Hälfte verringert worden. Außerdem öffnet und schließt die Klappe für das Einlegen und Entnehmen der Wafers ca. 40% schneller als bei der Serie H1. Wie beim TAS450 Typ A2

wird eine innovative Klappe eingesetzt, um zu verhindern, dass Partikel entstehen oder eindringen können.

Glossar

- FOUP: Ein Transportbehälter zur Übergabe von Halbleiter-Wafers, der von der SEMI, einer Organisation der Hersteller von Produktionsanlagen für Halbleiter, genormt worden ist

Hauptanwendungsgebiete

- Automatisierter Transport von Siliziumwafers zwischen verschiedenen Maschinen zur Halbleiterproduktion.

Über die TDK Corporation

Die TDK Corporation ist ein führendes Elektronikunternehmen mit Sitz in Tokio, Japan. Es wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung von elektronischen und magnetischen Produkten Schlüsselmaterialien sind. Heute umfasst das TDK Portfolio passive Bauelemente und Produkte für magnetische Anwendungen genauso wie Komponenten zur Speicherung elektrischer Energie, digitale Speichermedien und sonstige Produkte. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte insbesondere im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik sowie der Konsum-, Automobil- und Industrie-Elektronik. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2012 erzielte TDK einen Umsatz von 9,9 Milliarden USD und beschäftigte rund 79.000 Mitarbeiter weltweit.

Den Text dieser Meldung sowie Bilder dazu können Sie unter www.tdk.co.jp/tdaah01/aah02200.htm herunterladen.

Kontakt für Medien

Kontakt	Telefon	Mail
Frank TRAMPNAU TDK Electronics Europe GmbH Düsseldorf, Deutschland	+49 211 9077 127	trampnau@eu.tdk.com